

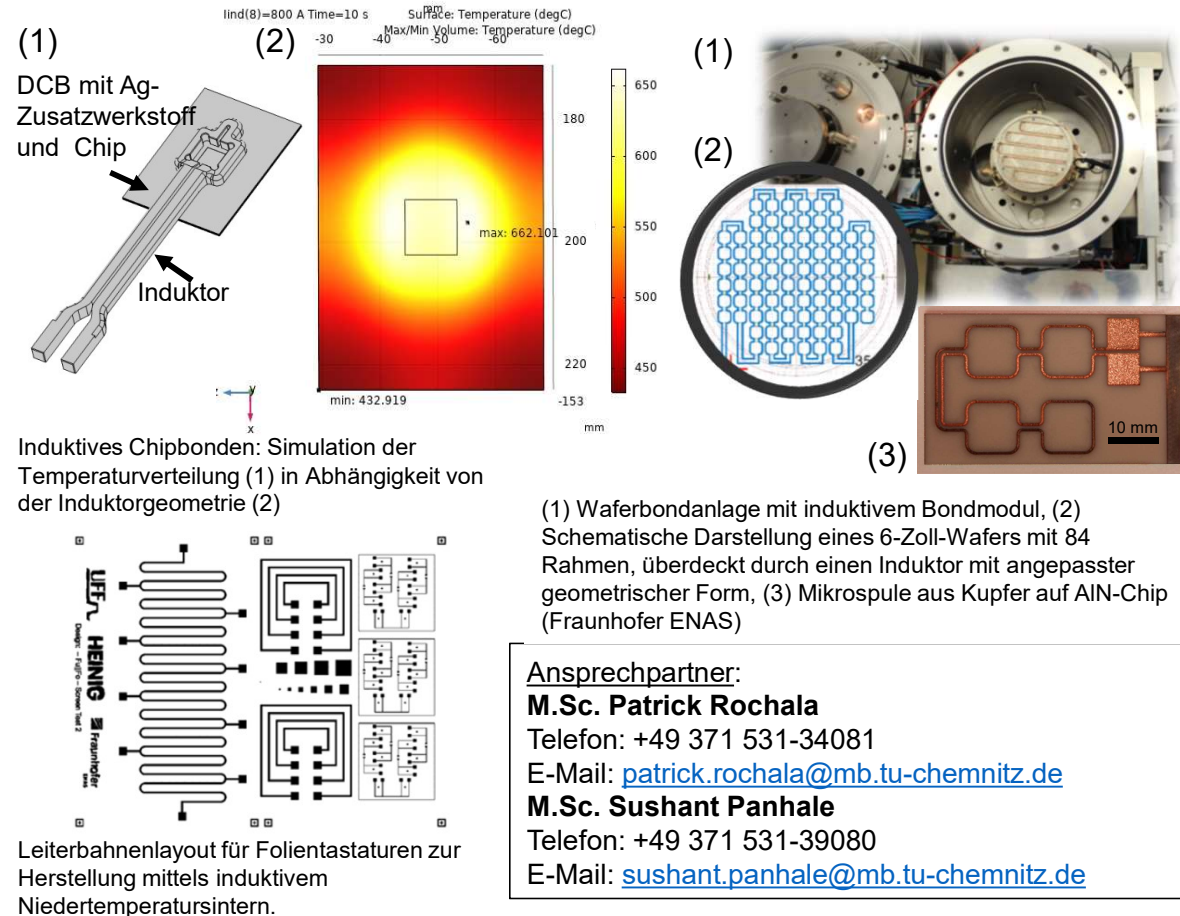
Schwerpunkte: Fügen in der Mikro- und Dünnschichttechnik

Anwendungen

- induktives Bonden auf Wafer- und Chip-Level
- induktives Sintern von n/ μ -Partikelpasten für Chipmontage, für die Erzeugung von Leiterbahnen, als Alternative zum Weichlöten
- Folienschweißen in der Verpackungsindustrie und der Elektronik

F&E-Schwerpunkte

- Auslegung und numerische Simulation von induktiven Erwärmungsprozessen
- quantitative und qualitative thermische Analyse
- Realisierung von Versuchsständen
- Durchführung induktiver Fügeprozesse
- Analyse und Qualifizierung der erzeugten Fügeverbindungen



Ansprechpartner:

M.Sc. Patrick Rochala

Telefon: +49 371 531-34081

E-Mail: patrick.rochala@mb.tu-chemnitz.de

M.Sc. Sushant Panhale

Telefon: +49 371 531-39080

E-Mail: sushant.panhale@mb.tu-chemnitz.de